



12. HardCopy III デバイスの パッケージ情報

この資料は英語版を翻訳したもので、内容に相違が生じる場合には原文を優先します。こちらの日本語版は参考用としてご利用ください。設計の際には、最新の英語版で内容をご確認ください。

HIII51012-1.0

はじめに

この章では、アルテラの HardCopy® III デバイスのパッケージ情報を提供しています。

デバイスおよび パッケージ情報

表 12-1に、HardCopy IIIデバイスおよびパッケージ情報の一覧を示します。

| デバイス | パッケージ | ピン |
|--------|----------------------|------|
| HC311W | FineLine BGA—ワイヤボンド | 780 |
| HC311F | FineLine BGA—フリップチップ | 780 |
| HC321W | FineLine BGA—ワイヤボンド | 780 |
| HC321F | FineLine BGA—フリップチップ | 780 |
| HC322L | FineLine BGA—フリップチップ | 1152 |
| HC322F | FineLine BGA—フリップチップ | 1152 |
| HC331W | FineLine BGA—ワイヤボンド | 780 |
| HC331F | FineLine BGA—フリップチップ | 780 |
| HC332L | FineLine BGA—フリップチップ | 1152 |
| HC332F | FineLine BGA—フリップチップ | 1152 |
| HC351W | FineLine BGA—ワイヤボンド | 780 |
| HC351F | FineLine BGA—フリップチップ | 780 |
| HC352L | FineLine BGA—フリップチップ | 1152 |
| | | 1517 |
| HC352F | FineLine BGA—フリップチップ | 1152 |
| | | 1517 |
| HC361W | FineLine BGA—ワイヤボンド | 780 |
| HC361F | FineLine BGA—フリップチップ | 780 |

表 12-1.HardCopy III デバイスのパッケージ一覧 (2 / 2)

| デバイス | パッケージ | ピン |
|--------|----------------------|------|
| HC362L | FineLine BGA—フリップチップ | 1152 |
| | | 1517 |
| HC362F | FineLine BGA—フリップチップ | 1152 |
| | | 1517 |
| HC372L | FineLine BGA—フリップチップ | 1152 |
| | | 1517 |
| HC372F | FineLine BGA—フリップチップ | 1152 |
| | | 1517 |



HardCopy III デバイスの熱抵抗仕様は、「[HardCopy Series Device Thermal Resistance Data Sheet](#)」を参照してください。



HardCopy III デバイスのパッケージ形状は、アルテラ・ウェブサイトの「[デバイス・パッケージ詳細](#)」ページからダウンロードできます。

参考資料

この章では以下のドキュメントを参照しています。

- 「[Device Packaging Specifications](#)」
- 「[HardCopy Series Device Thermal Resistance Data Sheet](#)」

改訂履歴

表 12-2 に、本資料の改訂履歴を示します。

| 表 12-2.改訂履歴 | | |
|-------------------|------|----|
| 日付およびドキュメント・バージョン | 変更内容 | 概要 |
| 2008 年 5 月 v1.0 | 初版 | — |